

(43) 国際公開日
2007 年 4 月 12 日 (12.04.2007)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2007/040047 A1

(51) 国際特許分類:

H01L 21/673 (2006.01) B65D 85/86 (2006.01)
B65D 21/02 (2006.01) H01L 21/677 (2006.01)
B65D 85/57 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2006/318582

(22) 国際出願日: 2006 年 9 月 20 日 (20.09.2006)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2005-288211 2005 年 9 月 30 日 (30.09.2005) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): ミライアル株式会社 (MIRAIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1710021 東京都豊島区西池袋 1 丁目 1 8 番 2 号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 兵部 行遠 (HY-OBU, Yukihiro) [JP/JP]; 〒1710021 東京都豊島区西池袋 1 丁目 1 8 番 2 号 ミライアル株式会社内 Tokyo (JP). 長田 厚 (OSADA, Atsushi) [JP/JP]; 〒4000011 山梨県甲府市上積翠寺町 1 6 6 1 株式会社ウインズ内 Yamanashi (JP).

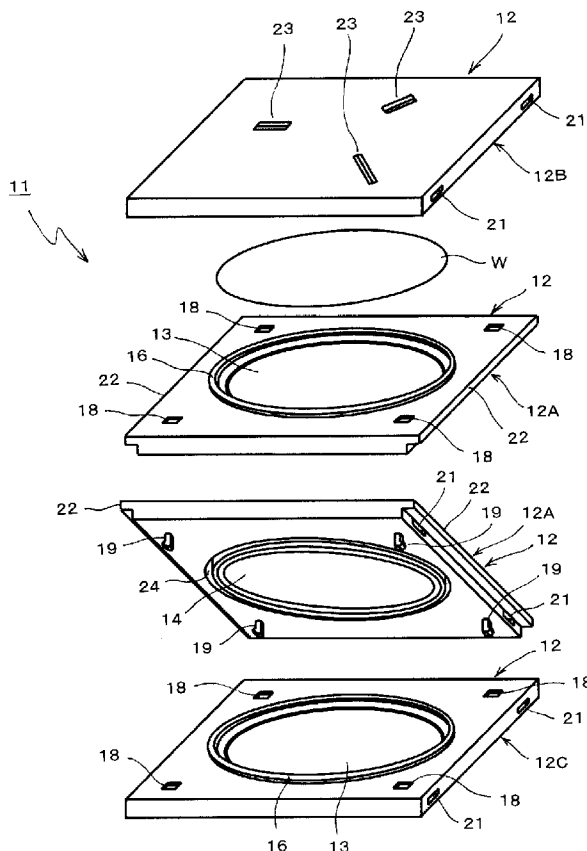
(74) 代理人: 工藤 宣幸 (KUDOH, Nobuyuki); 〒1710022 東京都豊島区南池袋 2 丁目 4 1 番 8 号 池袋睦ビル 2 階 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HN,

[続葉有]

(54) Title: THIN BOARD HOLDING CONTAINER AND PROCESSING APPARATUS FOR THIN BOARD HOLDING CONTAINER

(54) 発明の名称: 薄板保持容器及び薄板保持容器用処理装置



(57) Abstract: A discretionary number of semiconductor wafers are flexibly supported on both upper and lower sides. A thin board holding container is provided for holding a plurality of semiconductor wafers to transfer, store and process them. The container is provided with a plurality of process trays stacked in a status where the process tray separately holds at least one semiconductor wafer; and a combining mechanism which integrally combines the process trays in a status where a plurality of process trays are stacked and divides them at discretionary positions. One side of the process tray is provided with a fixing holding section of one side, which holds at least one semiconductor wafer on one side, and the other side of the process tray is provided with a fixing holding section of the other side, which forms a storage space for fixing and holding the thin board by isolating the thin board from external environment by fitting in each other with the fixing holding section of the other side of other process tray. Thus, the process trays of the number in accordance with the number of the semiconductor wafers are stacked and the thin board holding container is constituted.

(57) 要約: 任意の枚数の半導体ウエハを、上下いずれの側にも柔軟に支持する。搬送、保管、処理等に用いるために複数の半導体ウエハを保持する薄板保持容器である。少なくとも 1 枚の半導体ウエハを個別に保持した状態で複数枚積層された処理トレイと、この処理トレイを複数枚積層した状態でこれらを一体的に結合すると共に任意の位置で分割する結合機構とを備えた。処理トレイは、その一側面に少なくとも 1 枚の半導体ウエハを保持する一側固定保

持部を備えると共に他側面に他の処理トレイの上記一側固定保持部と互いに嵌合することで外部環境と隔離して上記薄板を固定して保持する収納空間を形成する他側固定保持部を備えた。これにより、半導体ウエハの枚数に応じた枚数の処理トレイを積

[続葉有]



HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG,

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。